



Stand: 21. Juli 2017

ENIG-PROZESS

ELECTROLESS NICKEL - IMMERSION GOLD



Electroless nickel - immersion gold

Chemisch Nickel - Sudgold (ENIG) ist eine plane, lötbare, metallische Endoberfläche auf Leiterplatten und keramischen Substraten. Sie dient dem Schutz des Kupfers vor Oxidation und gewährleistet die Lötfähigkeit sowie Bondbarkeit mit Aluminiumdraht.

Bei diesem Verfahren wird auf die für die Endoberfläche vorgesehenen Flächen und Durchkontaktierungen in einem außenstromlosen Verfahren zuerst eine Nickelschicht als Diffusionssperre zum Kupfer und im zweiten Schritt eine dünne Goldschicht aufgebracht. Die Funktionalität des Goldes verhindert zuverlässig die Nickeloxidation und bestimmt maßgeblich die sehr gute Lötfähigkeit der ENIG-Oberfläche auch nach langen Lagerzeiten der Leiterplatten.

Durch eine hervorragend abgestimmte Vorbehandlung sind auch feine Leiterbahnstrukturen prozesssicher zu beschichten. Natürlich erfüllt die ENIG-Oberfläche auch die aktuellen Anforderungen von RoHS und WEEE.



Vorteile

- Endoberfläche für Leiterplatten zum Löten sowie Bonden mit Al-Draht
- hohe Lötstellenzuverlässigkeit mit bleifreien und bleihaltigen Loten
- hervorragende Kontaktoberfläche
- chemische Nickelabscheidung mit bester Kantenabdeckung und Feinleiterfähigkeit
- kosteneffektiver als elektrolytische Goldschichten

Anwendungen

- Leiterplatten und Substrate in SMD-, CoB- und HDI-Technik
- Schaltungen für Löt- und Al-Drahtbondanwendungen
- Kontaktflächen für Tastaturen

ENIG-PROZESS

ELECTROLESS NICKEL - IMMERSION GOLD

TECHNISCHE DATEN CHEMISCHE NICKELABSCHIEDUNG

Elektrolytcharakteristik NIMUDEN® NPR-Serie

Elektrolyttyp	Autokatalytische Ni-Abscheidung
pH-Wert und Temperatur	4,6 bei 80 - 84 °C
Abscheiderate	ca. 12 µm / h

Schichtcharakteristik NIMUDEN® NPR-Serie

Überzug	Nickel-Phosphor
Phosphorgehalt	6 - 9 %
Empfohlene Schichtdicke	4,0 - 7,0 µm

TECHNISCHE DATEN SUDGOLDABSCHIEDUNG

Elektrolytcharakteristik Gobright® Sudgold-Elektrolyte

Elektrolyttyp	Ladungsaustausch
Metallgehalt (je nach Elektrolyttyp)	0,4 - 2,0 g/l Au
pH-Wert	schwach sauer bis neutral
Temperatur (je nach Elektrolyttyp)	80 - 85 °C

Schichtcharakteristik Gobright® Sudgold-Elektrolyte

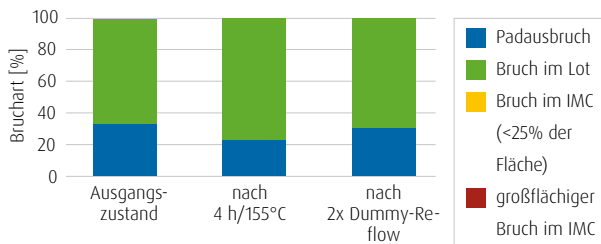
Überzug	Feingold
Empfohlene Schichtdicke	0,05 - 0,10 µm

ENIG-PROZESS

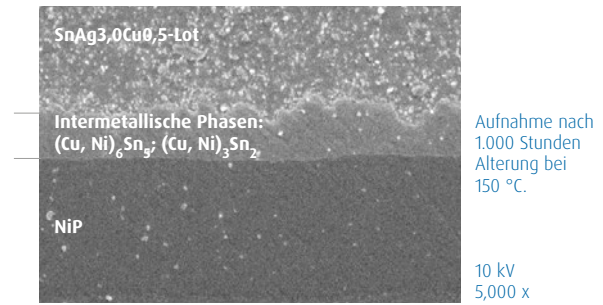
ELECTROLESS NICKEL - IMMERSION GOLD

Ergebnisse von BGA-Scherversuchen

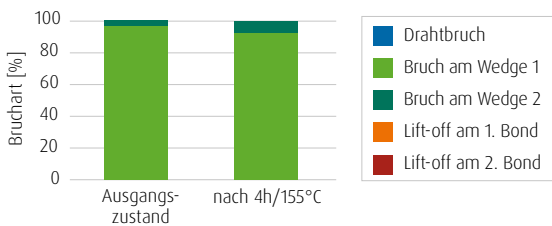
(0,76 mm-Kugeln aus SnAg4Cu0,5; 5 µm NiP, 70 nm Au)



REM-Aufnahme eines Querschnitts durch eine Lötstelle einer ENIG-Schicht



Ergebnisse von Abzugsversuchen nach Bonden mit AlSi1-Draht (25 µm)



Mittlere Abzugskräfte > 7 g
Relative Standardabweichung max. 15 %
Keine Abheber (Lift-offs)

Umicore Galvanotechnik GmbH

Klarenbergstrasse 53-79
73525 Schwaebisch Gmuend (Germany)

Technical Support: Phone +49 7171 607-357
Sales Department: Phone +49 7171 607-229

www.ep.umicore.com


umicore
Electroplating

The information and statements contained herein are based on our experience in the fields of research and applied technology and are believed to be accurate at the time of publication, but - unless agreed in writing - we make no warranty with respect thereto, including but not limited to any results to be obtained. This product information sheet in the English language prevails any translation.